

BGA测试架 气敏元件测试仪

产品名称	BGA测试架 气敏元件测试仪
公司名称	深圳市希科微科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:气敏元件测试仪 品牌:其他
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区共乐路25号503(办公场所)
联系电话	13632691984 13923764543

产品详情

产品详细说明 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 标准编号:-- 品牌:xkei 材质:电木、合金 是否进口:否 型号:bga 规格:-- 适用机床:bga 是否库存:非库存 是否批发:非批发 bga封装测试治具:

bga封装测试治具主要用途:芯片的来料检测,返修检测.

我们根据不同规格的芯片和种类的产品,从动作结构和连接方式上设计了不同类型的治具以供选择.

治具结构类型 1.翻盖式 适用的产品类型:尺寸小的pcb板,如手机、数码相机、mp3/mp4等产品。

适用的芯片类型:封装尺寸20*20mm以下,球数在300pin内的产品。 2.夹手式

适用的产品类型:尺寸中等和外接端口较多的pcb板,如网络路由器、数码相机、mp3/mp4等产品。

适用的芯片类型:封装尺寸30*30mm以下,球数在300pin内的产品。 3.旋压式

适用的产品类型:pcb板尺寸和芯片尺寸较大的产品,如电脑主板,游戏机,打印机等产品。

适用的芯片类型:封装尺寸30*30mm以上,球数在500pin以上的产品。 治具连接方式 1.pogo pin连接 优点

:维修时主板拆换方便快捷,探针长度较短,最大的减少针间信号的串扰,可用作高频信号点的测试。

缺点:成本较高,针头弹力、刺穿能力较弱,针盘结构在待测的主板尺寸太大时需有辅助定位孔、紧固

螺丝孔。 2.转接针焊接型

优点:成本较低,特别适合大尺寸且没有紧固螺丝孔、定位孔的pcb板和点数较多、尺寸较大的芯片。

缺点:维修时交换主板需要专用返修工具,转接针盘循环焊接最多2-3次即要报废更新。制作精度

可制作的球距从1.27mm-1.0mm-0.8mm-0.65mm-0.5mm-0.4mmpitch

本产品的加工定制是是,类型是气敏元件测试仪,品牌是其他,型号是00003,测量范围是0-12V,测量频率是2HZ (Hz),测量精度是0.8MM,适用范围是网络播放器、机顶盒,重量是3KG (kg),尺寸是3*3CM (mm)